

請求の範囲

- [請求項1] 基材フィルムと、前記基材フィルムの少なくとも一面側に形成された粘着剤層とを有する粘着テープを有し、
- 前記粘着テープは、MD方向における熱機械特性試験機により昇温時に測定した40℃～80℃の間の1℃毎の熱変形率の平均値と、TD方向における熱機械特性試験機により昇温時に測定した40℃～80℃の間の1℃毎の熱変形率の平均値との和がマイナス値であることを特徴とする半導体加工用テープ。
- [請求項2] 前記粘着剤層側に、接着剤層が積層されていることを特徴とする請求項1に記載の半導体加工用テープ。
- [請求項3] フルカットおよびハーフカットのブレードダイシング、レーザーダイシング、またはレーザーによるステルスダイシングに用いられることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の半導体加工用テープ。
- 。